

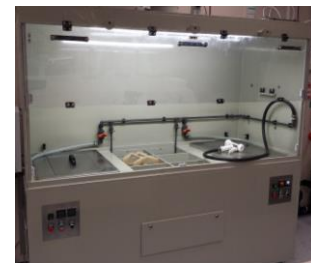
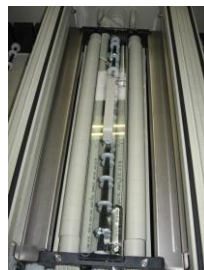


HEIßLUFT-VERZINNUNGS-ANLAGE

Erhältlich Typen:: 18"x18" bis zu 30"x30"
 SPS gesteuerte oder elektrisch gesteuerte Ausführung
 Für Blei Zinn oder Bleifreie Anwendung.

HCL ANLAGEN / SPEZIALPRODUKTE

Polypropylen-Linien oder Anwendungen:
 Spülen / Trocknen, Vor- und Nachreinigung, Fluxgeräte,
 Dosiereinheiten, Misch- und Puffertanks, Kundenspezifisch,
 Prototyp und Spezial
 Anwendungen.



VERTIKALE PLATING LINIEN (VPL)

Automatische Leiterplattenanlagen
 für die Oberflächenbehandlungs-
 verfahren für Kupfer Leiterplatten-
 aufbau, ENIG, ENEPIG Linien usw.
 Oberflächenbehandlungslinien für
 Forschung, Entwicklung und
 manuelle Fertigung.

New Technology Overman hat sich spezialisiert auf Design, Entwicklung, Herstellung und liefern von komplette Hot Air Solder Levellers , HASL Prozesslinien , galvanotechnischen Anlagenbau von Leiterplattenanlagen in Gestell- oder Korbtechnik für die Oberflächenbehandlungsverfahren in der gedruckten Leiterplatten Industrie.